

⑫ 公開実用新案公報(U) 平2-9461

⑬ Int. Cl.⁵H 01 S 3/18
3/043

識別記号

庁内整理番号

7377-5F

⑭ 公開 平成2年(1990)1月22日

7630-5F

H 01 S 3/04

S

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全2頁)

⑮ 考案の名称 半導体レーザー装置用パッケージ

⑯ 実 願 昭63-88754

⑰ 出 願 昭63(1988)7月4日

⑱ 考 案 者 木 下 喜 順 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

⑲ 考 案 者 江 部 正 義 長野県長野市大字栗田字舎利田711番地 新光電気工業株式会社内

⑳ 出 願 人 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

㉑ 出 願 人 新光電気工業株式会社 長野県長野市大字栗田字舎利田711番地

㉒ 代 理 人 弁理士 綿貫 隆夫 外1名

⑳ 実用新案登録請求の範囲

半導体レーザー素子が接合される接合面を有する放熱体が基板上に立設され、半導体レーザー素子からの光を受光するモニター素子の接合面が基板上に形成される半導体レーザー装置用パッケージにおいて、

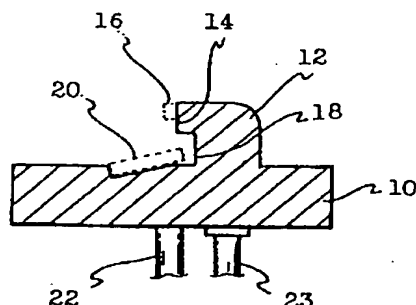
前記放熱体の接合面下部に、前記基板上の接合面に接合されるモニター素子の放熱体側の端部を収容する凹部を形成したことを特徴とする半導体レーザー装置用パッケージ。

図面の簡単な説明

第1図は本考案に係る半導体レーザー装置用パッケージの気密ガラス端子の一実施例を示すX-X'断面図、第2図は平面図、第3図はY-Y'断面図、第4図は従来の気密ガラス端子の構造を示す断面図である。

10……基板、12……放熱体、14……接合面、16……半導体レーザー素子、18……凹部、20……モニター素子、22……リードピン。

第 1 図



第 2 図

